


# AI 晶片系統軟硬整合架構師

人工智慧晶片是半導體產業下一波成長的動能，未來將驅動更多各式各樣的人工智慧新應用到產業各個層面，改變你我的日常生活，對人類社會影響十分深遠，所帶來的市場商機更是絕對不容錯過。身為半導體產業的成員，需要瞭解人工智慧晶片設計的所有環節。本課程引領您從基礎開始，結合實際案例討論，一步步進入 AI 專業領域成為 AI 晶片系統軟硬整合架構師。

課程目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 瞭解人工智慧晶片系統發展趨勢</li> <li>❖ 掌握人工智慧晶片軟硬體設計實務</li> <li>❖ 瞭解 AI 邊緣運算的技術趨勢</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 運用 AI 模型如何在嵌入式系統和加速晶片中實施</li> <li>❖ 瞭解設計 AI 加速晶片與客製化基本概念</li> <li>❖ 熟悉如何評估 AI 演算法與系統效能</li> <li>❖ 熟悉 AI 系統晶片技術的最新發展</li> </ul>	
	課程大綱	課程內容	課程時數	課程重點
	人工智慧邊緣運算	6 小時	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.人工智慧邊緣運算發展趨勢</li> <li>2.加速深度學習演算法開發</li> <li>3.人工智慧系統晶片架構分析</li> <li>4.人工智慧處理器設計與案例研討</li> </ol>	
	人工智慧軟硬整合系統	6 小時	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.AI 晶片架構設計挑戰</li> <li>2.人工智慧晶片設計流程簡介</li> <li>3.應用解析模型於人工智慧晶片架構分析實務探討</li> </ol>	
博士級講師群	黃立仁 博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼學歷：台灣大學 電機博士</li> <li>▼現任：工業技術研究院 資訊與通訊研究所 組長</li> <li>▼經歷：智慧決策晶片 計畫主持人</li> </ul>		
	羅賢君 博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼學歷：成功大學 電機博士</li> <li>▼現任：工業技術研究院 資訊與通訊研究所 技術副理</li> <li>▼經歷：人工智慧處理器晶片開發平台 計畫主持人</li> </ul>		
	陳耀華 博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼學歷：元智大學 通訊博士</li> <li>▼現任：工業技術研究院 資訊與通訊研究所 技術經理</li> <li>▼經歷：系統整合軟體設計環境與標竿分析 計畫主持人</li> </ul>		
課程對象	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.具有嵌入式系統、晶片設計概念</li> <li>2.具有 AI 模型訓練、邊緣運算實施經驗</li> <li>3.IC 設計業者、半導體業者、系統業者之工程師級主管</li> <li>4.對 AI/DNN 專用處理器有興趣者</li> <li>5.對 AI/DNN 訓練框架與軟硬整合有興趣者</li> <li>6.對於人工智慧晶片設計有興趣者</li> </ol>			
課程日期	108 年 10 月 24 日、108 年 10 月 25 日(週五) 9:30~16:30 共計 12 小時			
課程地點	新竹市東區光復路二段 295 號 3 樓之 2 (電腦教室)			
課程費用	課程優惠價	早鳥優惠(10/9 前)	兩人同行優惠價 工研人/學生	
	7,500 元/人	7,200 元/人	7,000 元/人	

<b>報名方式</b>	採線上報名，或掃描右方 QR code！
<b>結業證書授予</b>	本課程參訓學員出席率達 80%以上且通過認證考試，將由 <b>工研院與台灣雲端物聯網產業協會</b> 共同頒發「AI 晶片系統軟硬整合架構師」合格證明。
<b>課程洽詢</b>	 04-25671917 朱小姐、04-25605409 吳小姐
<b>其他注意事項</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，敬請來電洽詢方完成報名。</li> <li>2.因課前教材、講義及餐點之準備及需為您處理相關事宜，若您繳費後不克前來，請於開課三日前打電話或MAIL告知，主辦單位將退還 80%課程費用，一旦開課，恕不退費。</li> <li>3.若原報名者因故不克參加，但欲更換他人參加，敬請於開課前二日通知。</li> </ol>

➤傳真報名表【04-25690361】 工研院 產業學院 台中學習中心【TEL.04-25671912】

### AI 晶片系統軟硬整合架構師 報名表

公司發票抬頭:					統一編號:	
地址:					發票： <input type="checkbox"/> 二聯式(含個人) <input type="checkbox"/> 三聯式	
姓名	部門	職稱	電話	手機號碼	電子郵件(請以正楷書寫)	
承辦人	姓名	部門	職稱	電話	傳真	電子郵件(請以正楷書寫)
繳費方式：						
<input type="checkbox"/> 信用卡 ( <b>線上報名</b> ): 繳費方式選「信用卡」, 直到顯示「您已完成報名手續」為止, 才確實完成繳費。						
<input type="checkbox"/> 匯款：土地銀行 工研院分行，帳號 <b>156-005-00002-5</b> ，戶名【財團法人工業技術研究院】						
<input type="checkbox"/> 支票：抬頭『財團法人工業技術研究院』，掛號寄至: <b>428 台中市大雅區中科路 6 號 4 樓(中科_工商管理大樓)</b> 工研院產業學院 台中學習中心 朱小姐 收						
* 相關收據證明請註明姓名與課程傳真回產業學院~ 客服專線：04-25671912 FAX：04-25690361						

~ 歡迎您來電索取課程簡章 ~ 服務熱線 04-25685000 ~ 工研院產業學院台中學習中心 歡迎您的蒞臨 ~